

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006年1月19日 (19.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2006/006377 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: HOIL 21/68,  
C23C 16/44, HOIL 21/22, 21/285, 21/31

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/01 1714

(22) 国際出願日: 2005年6月27日 (27.06.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

ほ0) 優先権子一タ:  
特願2004-205577 2004年7月13日 (13.07.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 竹下光徳 (TAKESHITA, Mitsunori) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 松田智行 (MATSDUDA, Tomoyuki)

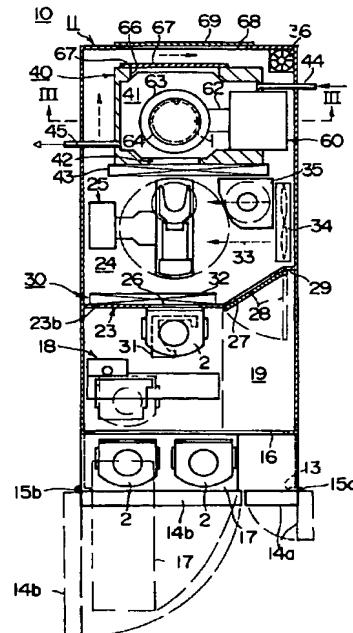
[JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 平野光浩 (HIRANO, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 佐藤明博 (SATO, Akihiro) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 森田慎也 (MORITA, Shinya) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 宮田敏光 (MIYATA, Toshimitsu) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP). 柴田剛史 (SHIBATA, Koji) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野3丁目14番20号 株式会社 日立国際電気内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 梶原辰也 (KAJIWARA, Tatuya); 〒1600023 東京都新宿区西新宿8丁目9番5号セントラル西新宿1-201号 Tokyo (JP).

/ 続葉有 J

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING EQUIPMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理装置および半導体装置の製造方法





(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KC, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -X—ラシT (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), Ξ—P ッ/i (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。